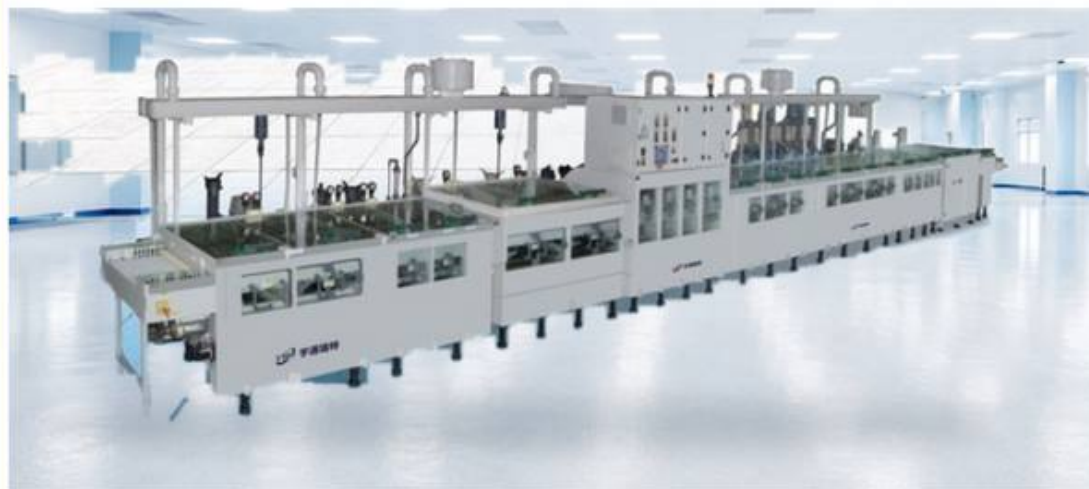


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Горизонтальные и вертикальные линии мокрых процессов
для PCB, FPCB, керамических подложек и полупроводников.



НАДЁЖНОСТЬ

Стабильные процессы

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Интеграция с MES

СЕРВИС

Поддержка и обучение

ЛИНИЯ SES



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прозрачные панели для визуального контроля.
- Минимальная ширина проводника/зазора: 3 mil / 3 mil.
- Равномерность C.O.V. $\geq 97\%$; коэффициент травления ≥ 4 .
- Компенсационная система повышает равномерность.
- Интеграция с MES.

НАЗНАЧЕНИЕ

Формирование наружного рисунка: снятие резиста, травление меди и снятие олова.

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ



ПЕМЗОВАЯ ОЧИСТКА

13



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ультразвуковая мойка очищает стенки отверстий.
- Мостовая конструкция предотвращает падение плат.
- Реверс хвостовых роликов снижает изгиб.
- Равномерная подача пемзовой суспензии и её возврат.
- Интеграция с MES.

НАЗНАЧЕНИЕ

Равномерная абразивная очистка меди перед нанесением паяльной маски.

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

